

## LED集成光源封装胶

### 简介

LED集成光源封装胶，又称大功率LED集成模组面光源混荧光粉用硅胶，以硅 - 氧 (Si - O) 键为主链结构。

### 特点

- 1、不易被紫外光和臭氧所分解.无双键存在。
- 2、高温下（或辐射照射）分子的化学键不断裂，可在-50 ~ 200 范转内长期使用.经过300 七天的强化试验后胶体不龟裂、不硬化。
- 3、胶体固化后呈无色透明胶状体，经260 的回流焊，对PPA及金属有一定的粘附性。
- 4、具有电气绝缘性能和良好的密封性。
- 5、适合自动或手工点胶生产贴片式、荧光粉胶；

### 技术参数

外观：无色透明液态

粘度 (CPS)：30000

混合粘度 (cps)：25000

密度 (g/cm<sup>3</sup>)：1.05

混合比例：A：B=1：1

允许操作时间 (分钟，25 )：180

固化条件：110 X1小时，然后150 X1小时

硬度 (shore A, 25 )：45

折射率 (633nm)：1.420

透光率 (450nm)：97%

剪切接着强度 (PPA,kg/nm<sup>2</sup>)：0.25

体积电阻系数 ( .cm)：1.0X10<sup>14</sup>

介电系数 (1.2MHz)：3.0

介质损耗角正切 (1.2MHz)：1X10<sup>-3</sup>

击穿电压 (KVmm)：>25

### 工艺流程

- 1、按重量比为A：B=1：1的比例配胶，搅拌10分钟。

- 2、真空脱泡20分钟。
- 3、在注胶之前，请将支架在150℃下预热60分钟以上除潮.尽快在支架没有重新吸潮之前封胶。
- 4、先110℃烤1个小时，然后升温到150℃烤1小时，分段固化可有效解决气泡问题提高成品率。

#### 注意事项

---

使用过程中应该注意避免与一下物质接触：

- 1、有机锡化合物和其它有机金属化合物。
- 2、含有机锡化合物的硅酮橡胶。
- 3、硫磺，多硫化合物、聚砷和其它含硫材料。
- 4、胺、氨基甲酸乙酯或其它含胺材料。
- 5、不饱和烃增塑剂。

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/baike/2796.html>